

Odstraňování laku z DPS při opravách

Vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům na ochranné laky pro desky plošných spojů bývá i větší problém s jeho odstraněním při případných opravách desek. Pro tyto případy bylo vyvinuto zařízení RemUVa™, pro odstraňování laku pomocí tryskání úzkého paprsku speciálního prášku.



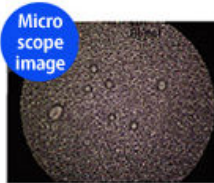
Solder Paste Mixer

THINKY

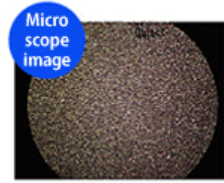


Zařízení na míchání pájecí pasty Vám umožní rychlé a homogenní promíchání pájecí pasty a její ohřev na pracovní teplotu. Pájecí pasta je tak připravena k použití již po cca 10 minutách od vytažení z lednice. Další výhodou je nulová kontaminace vzdušnou vlhkostí během míchání.

Manual stirring



SR-500 stirring



Pájecí materiály Qualitek

lead free **QUALITEK**
soldering

Firma Qualitek nabízí široké spektrum produktů pro pájení. Jedná se zejména o následující produkty:

- Pájecí pasty – olovnaté i bezolovnaté s velikostí zrna pájecího prášku Typ3 a Typ4
- Pájecí pasty v kartuši pro dispensery - olovnaté i bezolovnaté s velikostí zrna pájecího prášku Typ3 a Typ4
- Pájecí dráty – olovnaté i bezolovnaté (od průměru 0,25mm)
- Tavidla pro pájecí vlny
- Tavidla pro opravy



Pro bližší informace a objednání vzorků nás kontaktujte.